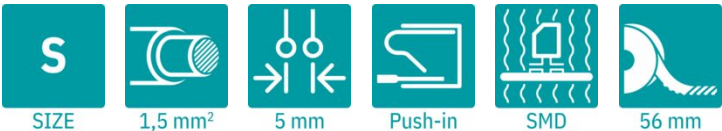


SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm², número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: SPT 1,5/-H-SMD, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Geometría pad lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho

Sus ventajas

- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
- La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
- Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
- Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.

Datos comerciales

Código de artículo	1223188
Unidad de embalaje	300 Unidades
Cantidad mínima de pedido	300 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AALDAA
Clave de producto	AALDAA
GTIN	4063151313913
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,908 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,908 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Terminal de tarjetas de circuitos impresos
Familia de productos	SPT 1,5/..-H-SMD
Línea de productos	COMBICON Terminals S
Número de polos	8
Paso	5 mm
Número de filas	1
Diseño del pin	Geometría pad lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	17,5 A
Tensión nominal U_N	320 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Sección nominal	1,5 mm ²
-----------------	---------------------

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Longitud de pelado	8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura SMD
Diseño del pin	Geometría pad lineal

Indicaciones de procesamiento

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Proceso	Soldadura por reflujo
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T _c	260 °C
Ciclos soldad. por reflujo	3

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (4 µm - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (4 µm - 8 µm Sn)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material aislante	LCP
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	175
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

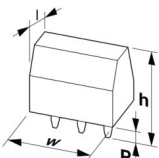
Datos del material: elemento de accionamiento

Color (Elemento de accionamiento)	blanco (9010)
Material aislante	PA GF
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los anclajes de soldadura en los polos exteriores reducen la tensión mecánica de los puntos de soldadura SMD.
Indicaciones de montaje	El artículo no es apto para una limpieza PCB con líquidos.

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	5 mm
Anchura [w]	39 mm
Altura [h]	10,3 mm
Longitud [l]	13,6 mm

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Altura total	7,7 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	2,6 mm
Dimensiones de patilla	0,7 x 0,3 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Geometría Pad	1,6 x 4 mm
Diámetro orificio	1,1 mm

Ensayos mecánicos

Comprobación de conexión

Especificación del ensayo	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultado	Prueba aprobada

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de tracción

Especificación del ensayo	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real	0,2 mm ² / rígido / > 10 N
	0,2 mm ² / flexible / > 10 N
	1,5 mm ² / rígido / > 40 N
	1,5 mm ² / flexible / > 40 N

Ensayo de flexión

Especificación del ensayo	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultado	Prueba aprobada

Ensayos eléctricos

Verificación de calentamiento

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Exigencia Ensayo de calentamiento	La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior.

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	250 V

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Tensión transitoria nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	4 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	3,2 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	500 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

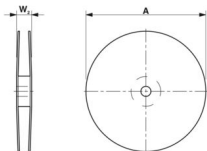
Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	5 s

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)

Información sobre el embalaje

Esquema de dimensiones	
Tipo de embalaje	Correa de 56 mm de ancho

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

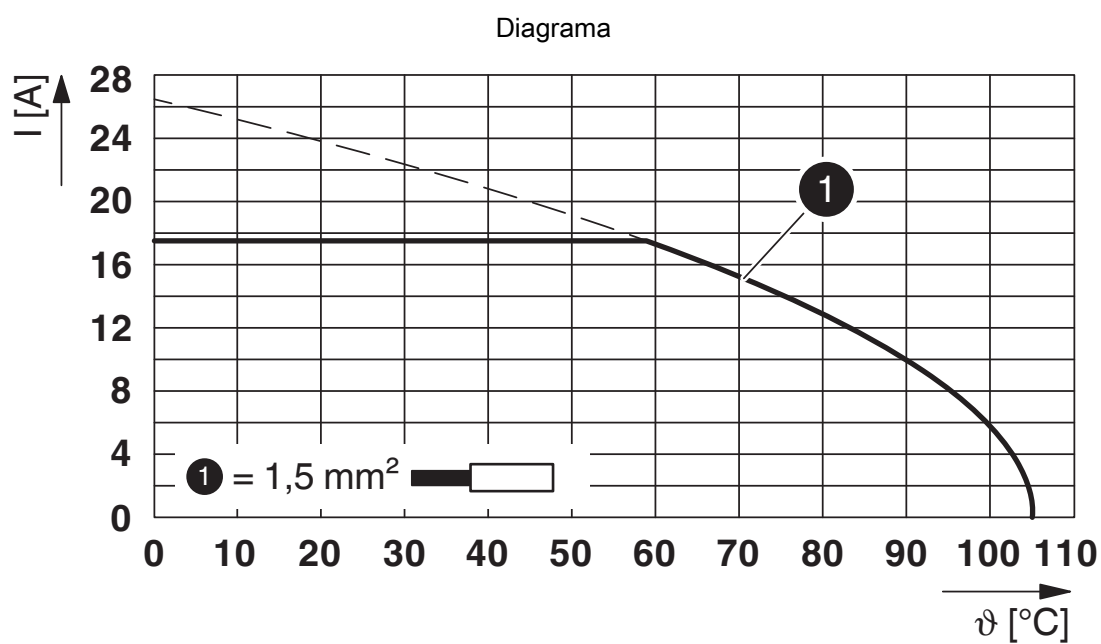
Ancho de cinta [W]	56 mm
Medidas exteriores de la bobina [W2]	≤ 62,4 mm
Diámetro de la bobina [A]	≤ 330 mm
Tipo del embalaje exterior	Bolsa transparente

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso

1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Dibujos



Tipo: SPT-SMD 1,5/...-H-5,0 R...

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPT-SMD 1,5/ 8-H-5,0 R56 - Borna para placa de circuito impreso



1223188

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1223188>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,085 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es